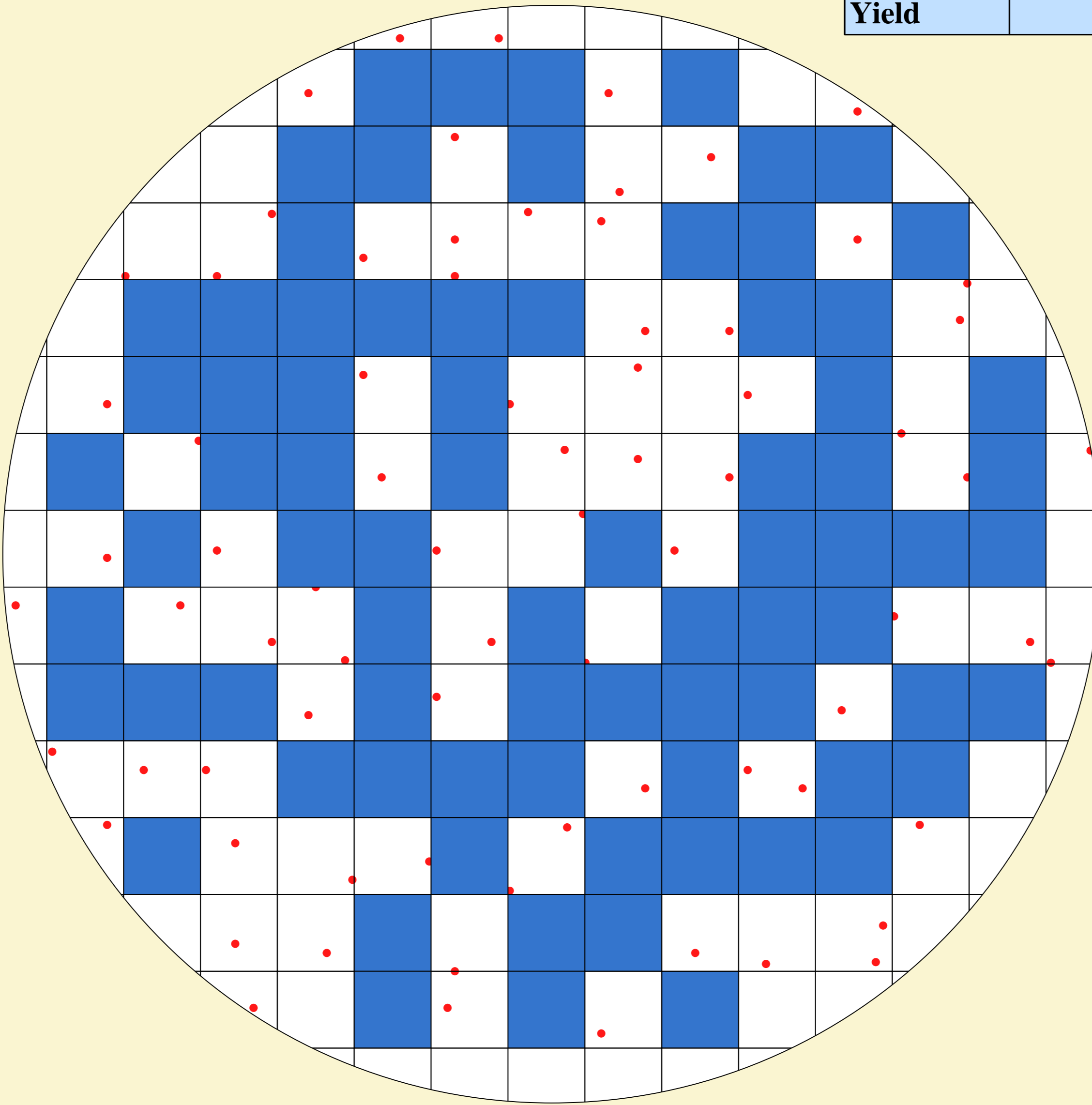


ダイサイズと歩留まりの関係の例

450mm² Die Example (300mm Wafer)

300mm Wafer

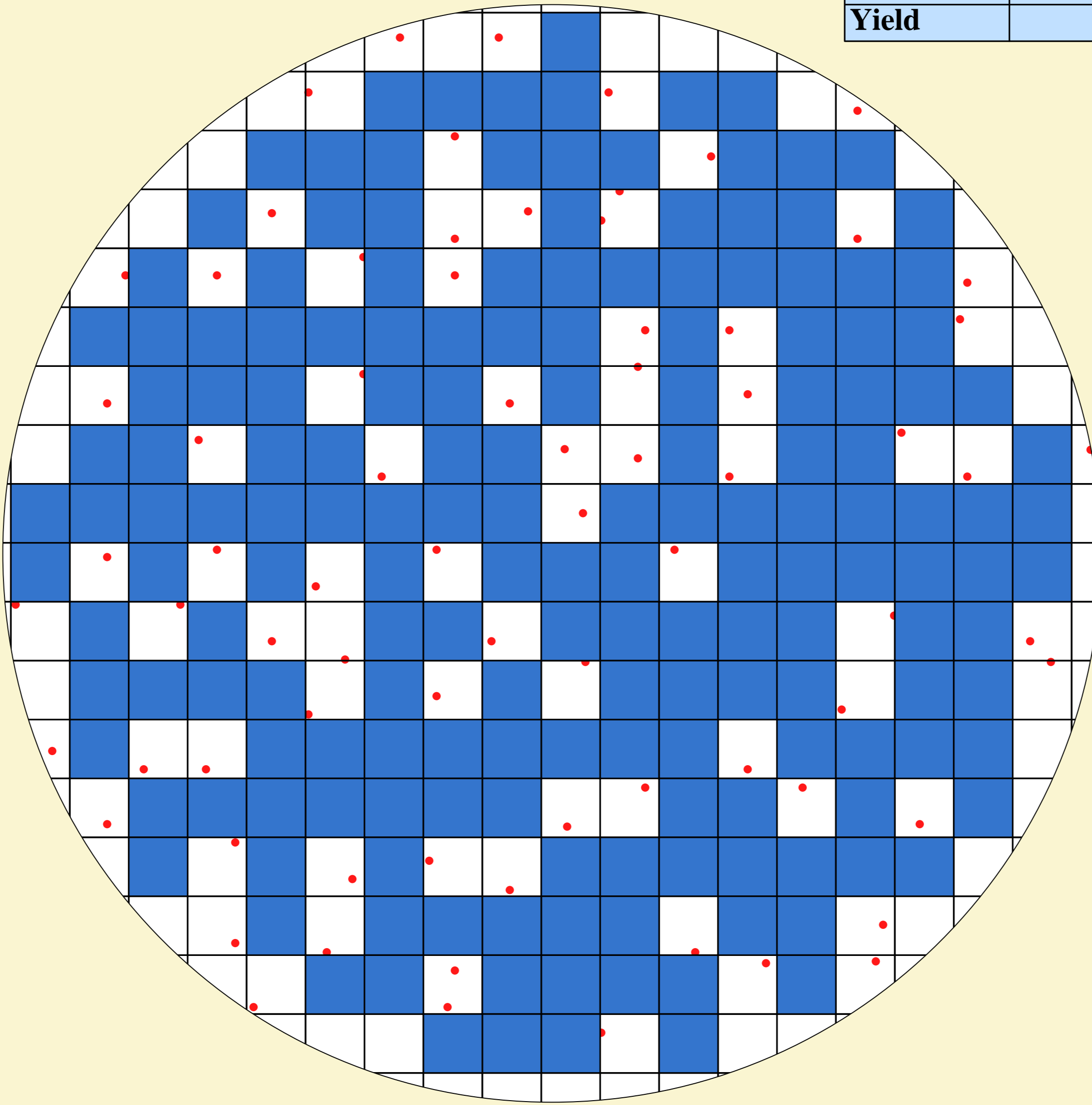
Total Die	136
Good Die	77
Yield	57%



260mm² Die Example (300mm Wafer)

300mm Wafer

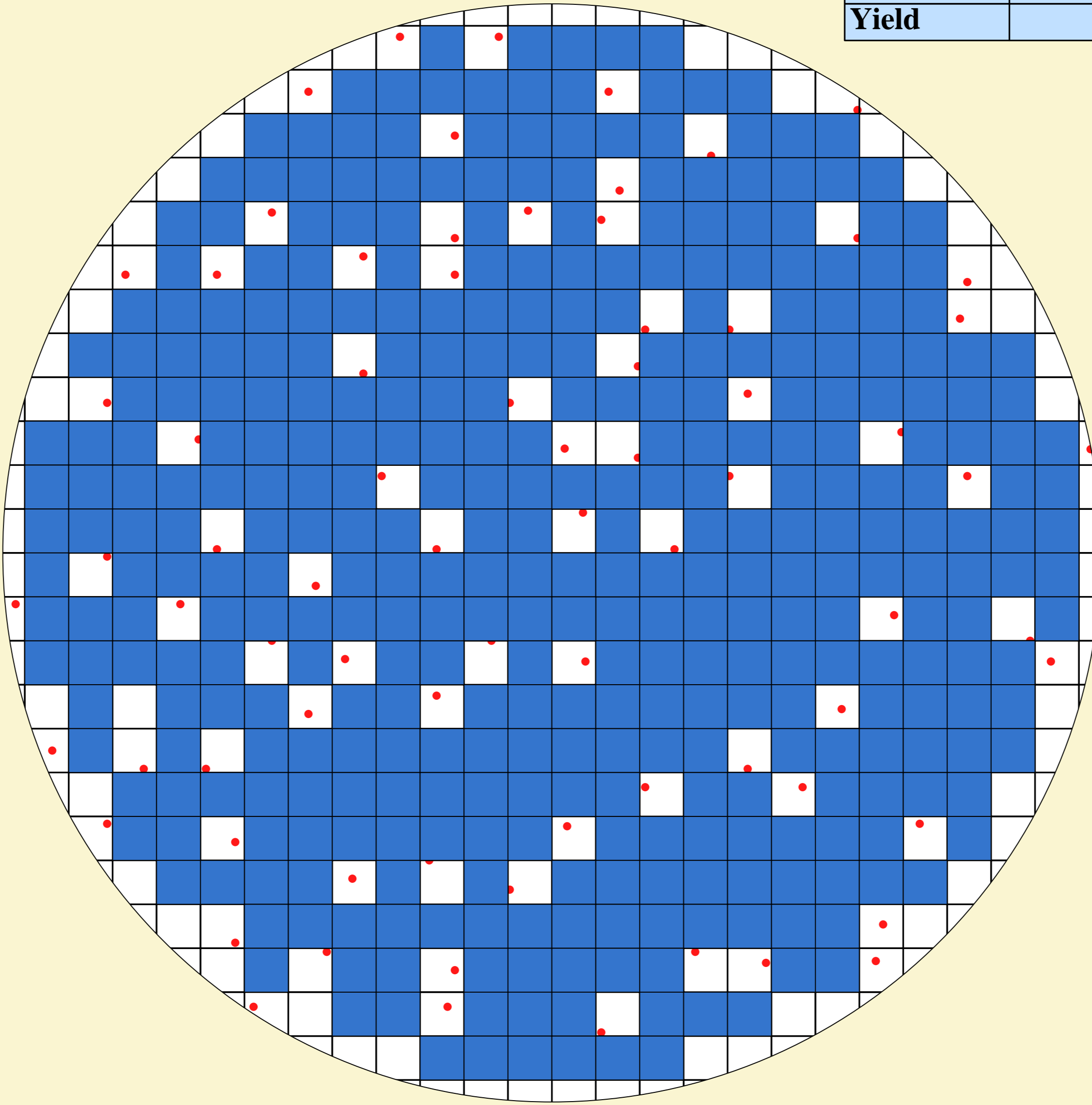
Total Die	239
Good Die	176
Yield	73%



140mm² Die Example (300mm Wafer)

300mm Wafer

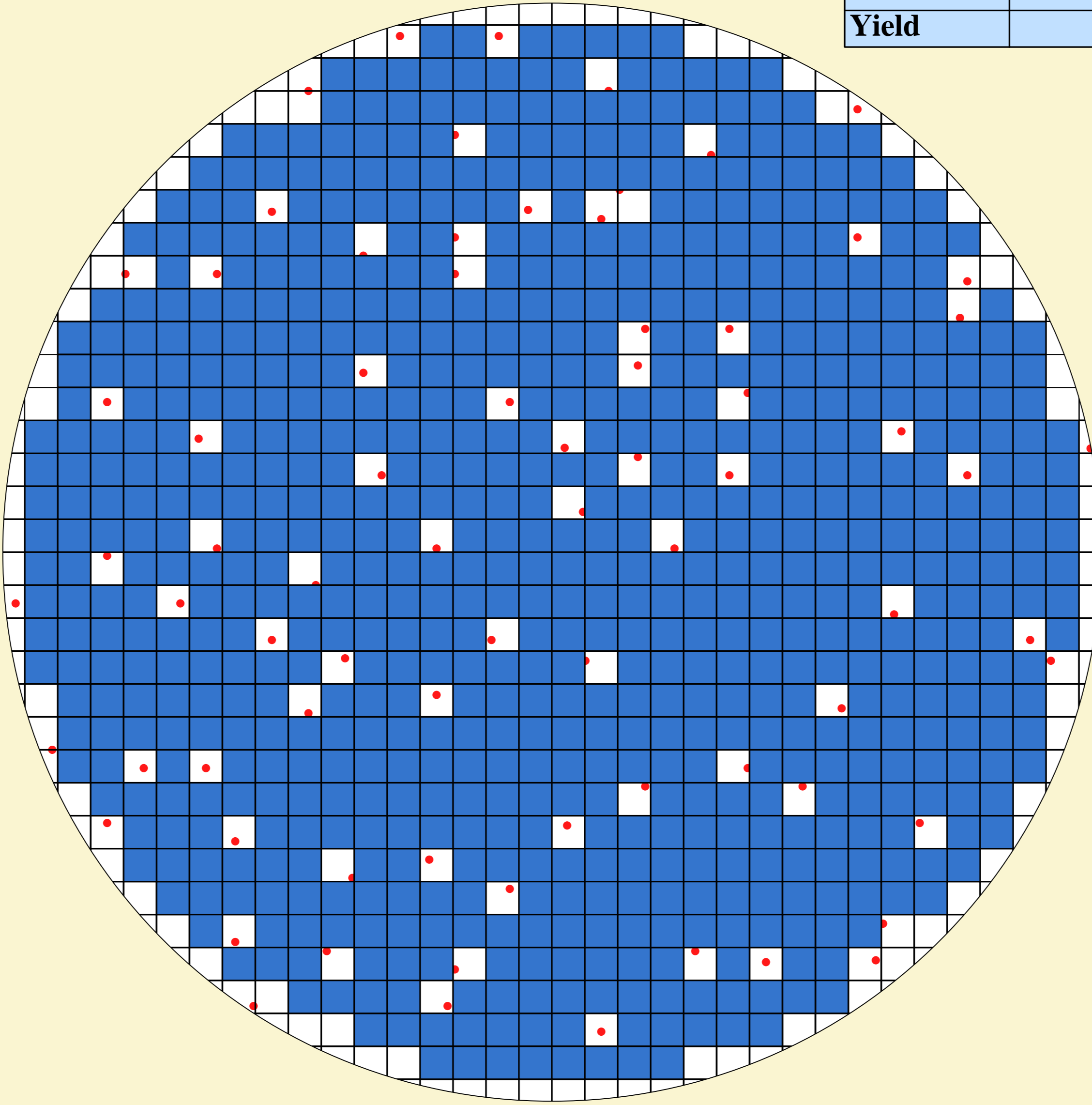
Total Die	442
Good Die	373
Yield	84%



80mm² Die Example (300mm Wafer)

300mm Wafer

Total Die	807
Good Die	737
Yield	91%



ダイが大きくなるにつれて歩留まりが低下、1枚のウエーハで製造できるチップ個数が激減する

ダイが小さくなるにつれて歩留まりが向上、1枚のウエーハで製造できるチップ個数が激増する